

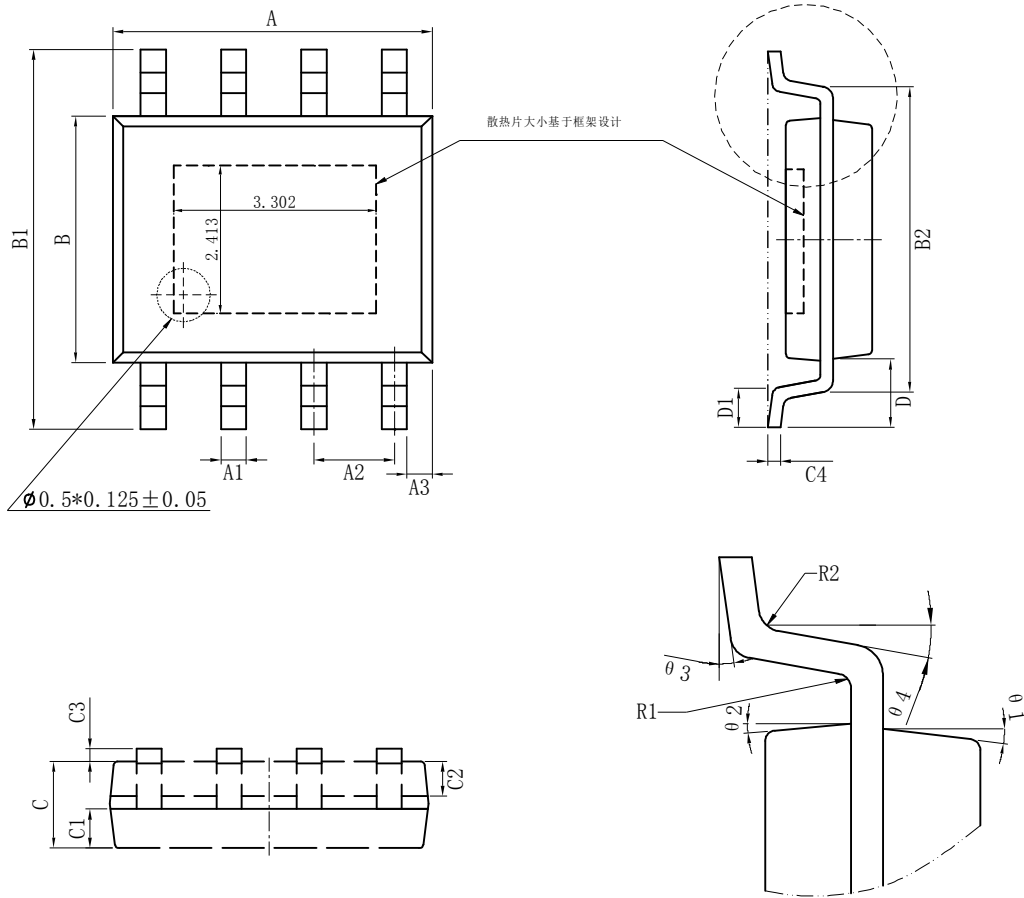


# 气派科技股份有限公司

China Chippacking Technology Co., Ltd

标注	尺寸	最小(mm)	最大(mm)	标注	尺寸	最小(mm)	最大(mm)
A		4.80	5.00	C3		0.00	0.09
A1		0.356	0.456	C4		0.203	0.233
A2		1.27TYP		D		1.05TYP	
A3		0.345TYP		D1		0.40	0.80
B		3.80	4.00	R1		0.20TYP	
B1		5.80	6.20	R2		0.20TYP	
B2		5.00TYP		θ 1		17° TYP4	
C		1.30	1.60	θ 2		13° TYP4	
C1		0.55	0.65	θ 3		0° ~ 8°	
C2		0.55	0.65	θ 4		4° ~ 12°	

\* ESOP Die pad exposur大小是根据引线框架设计。



未注尺寸公差
x-----±0.5
x.x-----±0.1
x.x x-----±0.01
x.x x x-----±0.005

制图	朱复国	2016.07.06	名称	生效日期		
审核			ESOP8 封装产品图	等级标记	重量	比例
批准						
单位	mm		图号	页数	第1页 共1页	
镀涂			C-0L-089	气派科技股份有限公司 CHINA CHIPPACKING TECH. CO., Ltd		
			版次	A		